

보이는 차이나

DeepSeek V4 + 화웨이 = 중국 기술자립 가속화

- 2025년 초, DeepSeek 열풍 이후 약 1년만에 신모델 V4 출시, 시장 기대감 회복과 함께 테크 섹터 상승 주도
- 화웨이 Ascend 기반 초노드 구조를 통해 칩 성능 한계를 시스템 효율로 보완한 효과 확인, 중국 기술 자립 빠른 진전 시사
- 화웨이 칩 기반 구조에서도 가격 경쟁력과 높은 성능을 유지하며 글로벌 LLM 산업 내 존재감 강화
- 화웨이 초노드 클러스터 확산은 '중국식 AI 인프라 구조' 재정립 기대, AI 인프라 밸류 체인 전반 수요 확대 기대

드디어 화웨이를 데리고 돌아온 DeepSeek V4

DeepSeek V4가 마침내 공개됐다 2025년 초 DeepSeek R1이 저비용·고성능 전략으로 시장에 충격을 준 이후 차세대 모델에 대한 기대감은 높았으나, 그간 출시가 지연되며 기술적 완성도와 인프라 제약에 대한 의구심이 제기되기도 했다.

출시 지연의 주요 원인은 고성능 연산 자원 확보와 초장문 컨텍스트 구현에 따른 비용 부담, 그리고 화웨이(Ascend) 기반의 최적화 등 인프라 측면의 기술적 과제 때문이었던 것으로 분석된다. 최근 제기된 자금 조달 이슈 또한 단기적인 리스크라기보다, 고성능 모델 개발과 대규모 인프라 구축을 병행하는 과정에서 발생한 전략적 투자 확대 국면으로 해석할 수 있다. 여기에 연구개발 역량 강화를 위한 핵심 인재 유치와 보상 체계 확대가 맞물리면서, 전반적인 비용 구조가 일시적으로 증가한 측면도 존재한다.

그럼에도 불구하고 V4가 Ascend 기반 초노드(Hyper-Node) 구조와 함께 공개된 점은 의미가 크다. 모델과 인프라를 통합한 기술 구현이 이미 일정 수준 궤도에 진입했음을 보여준다. 동시에 중국 기술 자립이 빠르게 진전되고 있음을 방증하는 사례로 해석된다.

자본시장의 반응도 즉각적이었다. V4 프리뷰 공개 이후 그간 부진했던 테크 섹터를 중심으로 투자 심리가 빠르게 회복되며 시장 분위기가 반전되었다. 특히 중국 반도체 및 AI 인프라 관련 종목들이 강세를 보였는데, 이는 모델 출시를 넘어 산업 전반에 미치는 영향력이 반영된 결과로 풀이된다. 중국 및 홍콩 증시 전반에도 기대감이 유입되며 주요 지수의 반등이 이어지고 있다. 반도체와 AI 인프라 업종이 상승을 주도하는 가운데, 과창50(STAR 50) 지수와 항셴테크지수 또한 강세를 나타냈다.

이번 이벤트를 통해 특히 Ascend 기반의 전환, 초노드(Hyper-Node) 클러스터 아키텍처의 확산, 가격 경쟁력이라는 세 가지 방향성이 동시에 부각되고 있다. 이는 기술 주도권, 인프라 구조, 시장 경쟁 방식 전반의 변화를 시사하며, 향후 산업 재편으로 이어질 가능성이 있다는 판단이다.

화웨이가 주도하는 중국식 AI 인프라 구조의 부상

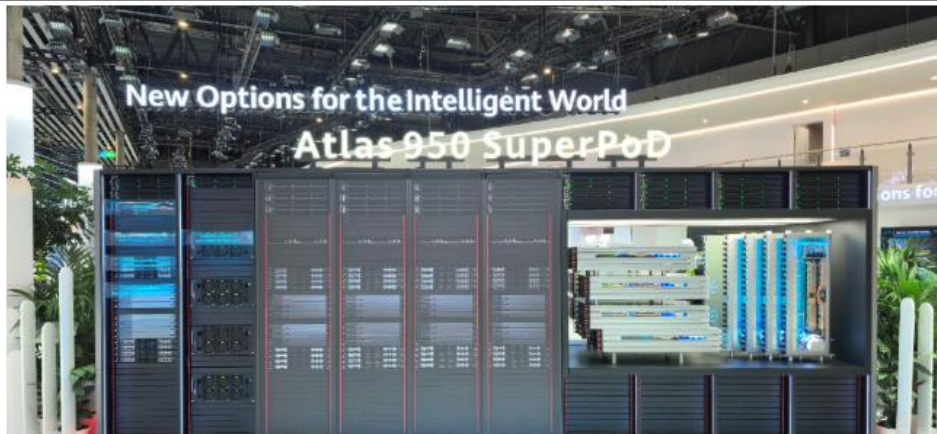
DeepSeek V4는 화웨이 Ascend 칩 기반으로 최적화되며, 중국 AI 산업이 엔비디아 중심 구조에서 벗어나 독자 기술 스택을 구축하는 흐름이 구체화되고 있음을 보여준다. CANN 프레임워크를 통해 CUDA 의존도를 낮추고, 칩-소프트웨어-모델이 통합된 구조가 실제 서비스 수준에서 구현되기 시작했다는 점이 핵심이다.

최근 엔비디아의 Jensen Huang CEO는 딥시크와 화웨이 칩의 결합 가능성에 대해 “미국에 끔찍한 결과(horrible outcome)가 될 수 있다”고 언급하며 경계감을 드러낸 바 있는데 미국 중심의 AI 기술 표준에서 이탈하는 시나리오가 현실화되는 것에 대한 우려를 반영한 것으로 풀이된다. 시장에서는 그간 기술적 난도와 생태계 장벽으로 인해 단기간 내 구현 가능성을 낮게 평가했으나, V4는 이러한 회의론을 불식시키는 계기가 되었다는 평가다

인프라 아키텍처 역시 구조적 전환 국면에 진입하고 있다. DeepSeek V4는 화웨이 기반 초노드(Hyper-Node) 구조 위에서 구동되며, 다수의 칩을 고속 인터커넥트로 연결해 하나의 연산 시스템처럼 활용하는 방식을 채택했다. 개별 칩 성능의 한계를 시스템 단위에서 보완하는 구조다. 이러한 전략은 올해 바르셀로나에서 열린 MWC에서 공개된 화웨이 ‘Atlas 950 SuperPoD’를 통해 구체화되었다. 최대 8,192개의 NPU를 연결하는 대규모 클러스터 구조와 UnifiedBus 기반 인터커넥트를 적용해 칩 간 통신 병목을 최소화하고, 전체 시스템이 하나의 컴퓨팅 단위처럼 작동하도록 설계된 점이 특징이다.

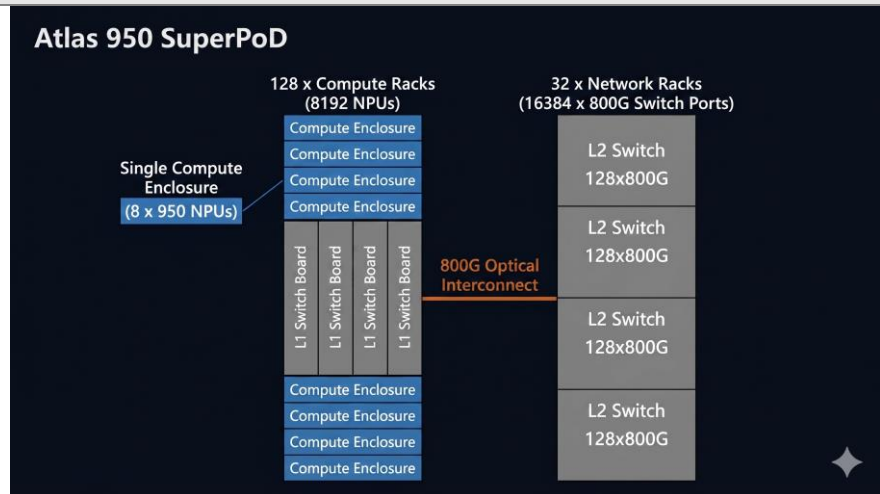
하드웨어 제약을 시스템 아키텍처로 해소하는 방식은 DeepSeek V4와 같은 상용 모델을 통해 실효성이 확인되고 있으며, 중장기적으로는 엔비디아 중심 구조에 대응하는 보완적 인프라 경로가 형성되는 동시에 ‘중국식 AI 기술 스택’의 핵심 경쟁력으로 발전할 가능성이 있다.

그림 1. 2026년 MWC에서 공개된 화웨이의 Atlas 950 SuperPod



자료: Baidu, 미래에셋증권 리서치센터

그림 2. 화웨이 Atlas 950 SuperPoD 아키텍처 및 세부 구성



자료: 미래에셋증권 리서치센터

가격 경쟁력과 성능 우위를 통한 시장 선점

DeepSeek V4는 V4-Pro와 V4-Flash 두 가지 라인업으로 공개되었으며, 최대 1M(100만 토큰)의 초장문 컨텍스트를 지원하는 것이 특징이다. 이는 대규모 데이터 처리와 에이전트(Agent) 기반의 복합 업무 수행 능력을 개선하며, 단순 질의응답을 넘어 실무 활용성을 확대하는 방향으로 진화했음을 보여준다.

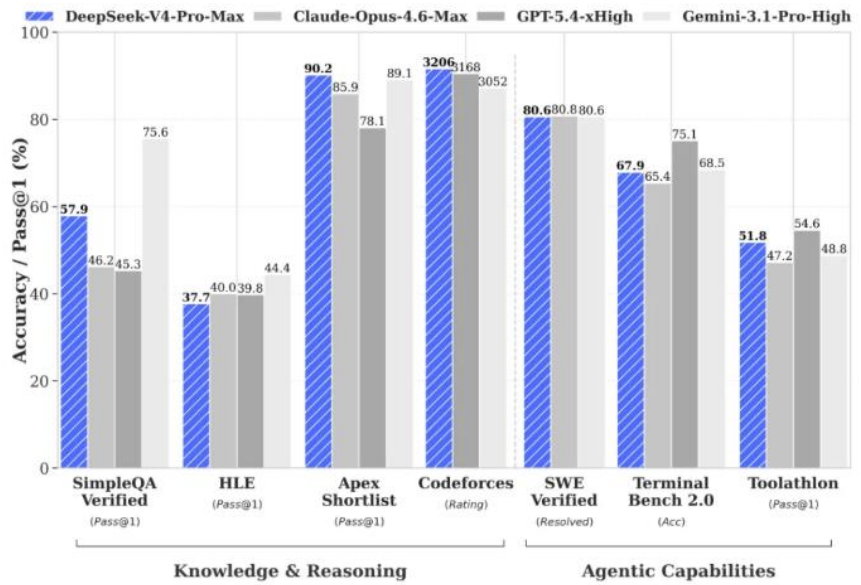
화웨이 Ascend 기반으로 최적화된 구조에서도 성능 저하 없이 글로벌 상위 모델과 유사한 수준을 유지하고 있다는 점이 중요하다. 고난도 추론 및 일부 학술적 영역에서는 여전히 GPT, Claude 등 선두 모델과 격차가 존재하지만, 코딩 및 실무형 벤치마크에서는 최상위권에 근접한 성능을 보인다. 특히 에이전트 기반 작업 환경에서 경쟁력이 확인되며, 실제 활용 관점에서의 완성도가 높아진 모습이다.

가격도 빼놓을 수 없는 핵심 경쟁력이다. GPT-5.5 대비 약 1/6~1/7 수준으로, 성능 대비 비용 효율이 크게 부각된다. 또한 최근 중국 AI산업에서는 알리바바, 텐센트 등 빅테크를 중심으로 API 가격 인상 흐름이 나타나고 있는 가운데, DeepSeek는 여전히 저가 전략을 유지하며 차별화된 포지셔닝을 이어가고 있다. 오픈소스 기반으로 상업적 활용 장벽이 낮다는 점도 도입 확대를 유도하는 요인이다. 출시 직후부터 5월 말까지 가격 할인 정책을 이어가며 개발자와 기업 고객 유입을 확대하는 모습이다.

또한 DeepSeek 측에서도 가격표 밑에 “고급 연산 자원 제약으로 현재 V4-Pro의 서비스 처리량은 제한적인 수준이나, 하반기 Ascend 950 기반 클러스터가 본격 도입될 경우 추론 비용이 추가로 낮아질 가능성이 있다”는 점을 언급하며 추가적인 가격 인하 가능성을 시사하고 있어, 향후 가격 경쟁력은 한층 강화될 것으로 예상된다.

DeepSeek V4는 ‘수용 가능한 성능’과 ‘낮은 비용 구조’를 결합해 시장 내 포지셔닝을 구축하고 있으며, 이러한 접근은 프리미엄 폐쇄형 모델뿐 아니라 중국 LLM 산업 전반에 새로운 가격·성능 기준을 제시하는 흐름으로 해석된다.

그림 3. DeepSeek vs 글로벌 최상위 모델 성능 비교



자료: DeepSeek, 미래에셋증권 리서치센터

표 1. 주요 LLM API 비용 비교

기업	LLM	입력 가격	출력 가격	총 비용	컨텍스트
Anthropic	claude-opus-4-7-thinking	\$5	\$25	\$30	1M
Anthropic	claude-opus-4-7	\$5	\$25	\$30	1M
Anthropic	claude-opus-4-6-thinking	\$5	\$25	\$30	1M
Anthropic	claude-opus-4-6	\$5	\$25	\$30	1M
Anthropic	claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k	\$5	\$25	\$30	200K
Anthropic	claude-opus-4-5-20251101	\$5	\$25	\$30	200K
Anthropic	claude-sonnet-4-6	\$3	\$15	\$18	1M
OpenAI	gpt-5.4-high (codex-harness)	\$2.50	\$15	\$17.50	1.1M
OpenAI	gpt-5.4-medium (codex-harness)	\$2.50	\$15	\$17.50	1.1M
구글	gemini-3.1-pro-preview	\$2	\$12	\$14	1M
구글	gemini-3-pro	\$2	\$12	\$14	1M
MoonShot	kimi-k2.6	\$0.74	\$4.66	\$5.40	256K
DeepSeek	deepseek-v4-pro-thinking	\$1.74	\$3.48	\$5.22	1M
Zhipu.AI	glm-5.1	\$1.05	\$3.50	\$4.55	202.8K
Zhipu.AI	glm-5	\$1	\$3.20	\$4.20	202.8K
MoonShot	kimi-k2.5-thinking	\$0.60	\$3	\$3.60	N/A
구글	gemini-3-flash	\$0.50	\$3	\$3.50	1M
알리바바	qwen3.6-plus	\$0.33	\$1.95	\$2.28	1M
Zhipu.AI	glm-4.7	\$0.38	\$1.74	\$2.12	202.8K

자료: LMArena Code Arena, 미래에셋증권 리서치센터

그림 4. V4-Pro 모델 하반기 가격 추가 인하 가능성도 언급

API 访问模型名	输入 (缓存命中)	输入 (缓存未命中)	输出	上下文长度
deepseek - v4 - pro	1 元	12 元	24 元	1M
deepseek - v4 - flash	0.2 元	1 元	2 元	

*受限于高端算力，目前 Pro 的服务吞吐十分有限，预计下半年昇腾 950 超节点批量上市后，Pro 的价格会大幅下调。

“고급 연산력 제약으로 인해 현재 Pro 모델의 서비스 처리량은 매우 제한적이며, 하반기에 Ascend 950 초노드가 대량 도입되면 Pro 가격이 크게 인하될 것으로 예상된다.”

자료: DeepSeek, 미래에셋증권 리서치센터

중국 AI 산업 영향력: 풀스택 구조로의 전환

이번 DeepSeek V4 발표는 중국 AI 산업이 ‘가성비 모델 중심 단계’를 넘어, 모델-칩-클러스터-클라우드로 이어지는 풀스택 구조 구축 단계로 진입했음을 보여준다. 이것은 기술 통합을 넘어 연산 자원 배분, 비용 구조, 모델 진화 속도까지 통제할 수 있는 산업 제어력 확보 전략으로 해석된다. 특히 미국의 수출 규제 환경 하에서 성능 자체보다 구조적 자립성과 운영 효율이 핵심 경쟁 변수로 부상하고 있다는 점에서 의미가 크다.

화웨이 Ascend 칩, 클러스터 기반 인프라, CANN 소프트웨어 스택이 결합되며 하드웨어부터 모델까지 연결된 독자 생태계 구축이 진행되고 있다. 엔비디아의 GPU 대체를 넘어 CUDA 중심 생태계와 다른 기술 경로를 형성하고 있으며, 개발 환경 측면에서도 CANN 기반 확산을 통해 점진적인 락인 구조도 만들어질 것으로 예상된다.

경쟁의 초점 역시 변화하고 있다. 개별 모델 성능 중심 경쟁에서 벗어나, 클러스터 효율, 네트워크 구조, 자원 스케줄링 등 인프라 레이어에서 결정되는 시스템 단위 효율과 비용 구조가 핵심 변수로 부상하고 있다. 최근 나타나는 가격 경쟁력 역시 모델 자체보다는 이러한 인프라 효율성의 결과물로 해석되며, 산업 경쟁 구도는 기술-인프라-운영을 통합한 구조로 이동하는 흐름이다.

중국 특유의 정책 기조와 자본 구조 역시 이러한 인프라 중심의 패러다임 전환을 강력히 뒷받침한다. 4월 정치국 회의를 통해 ‘인공지능 플러스(AI+)’ 전략과 연산 인프라 확충의 중요성이 재차 강조되었으며, AI의 산업 전반 확산과 연산력 네트워크 및 데이터센터 등 기초 인프라 투자를 병행하는 국가적 방향성이 더욱 선명해졌다.

특히 국유 자본 중심의 공공 인프라와 민간 기업의 AI 역량이 결합된 ‘민관 병행 구조’는 기술 자립과 외형적 성장을 동시에 달성하는 핵심 동력으로 작동하고 있다. 이러한 자본 투입 구조는 개별 기업의 리스크를 분산시키는 동시에 산업 전반의 스케일을 비약적으로 확장시키는 흐름을 가속화할 것으로 예상된다.

투자 시사점: 시스템 중심 전환과 AI인프라 밸류체인 수혜

DeepSeek V4는 중국 AI 산업이 개별 칩 성능을 중심으로 한 경쟁보다 시스템 단위의 규모와 밀도를 활용하는 인프라 중심 구조로 이동하고 있음을 보여준다. 단일 칩 성능이 엔비디아 대비 열위에 있는 상황에서도, 다수의 칩을 저지연으로 연결한 클러스터 아키텍처를 통해 상위권 모델 구현이 가능하다는 점이 확인된 사례다. 미·중 기술 환경을 고려할 때, 이러한 접근은 향후에도 지속될 가능성이 높다.

이와 같은 초노드 중심 전략은 글로벌 대비 중국 인프라 밸류체인에 상대적으로 강한 수요를 유발하는 구조다. 동일한 연산 성능을 확보하기 위해 더 많은 NPU와 연결 자원이 필요하며, 이에 따라 광모듈(800G/1.6T), 인터커넥트 장비, PCB 등 네트워크 및 기판 관련 투입 밀도가 높아지는 특징을 보인다. 칩 간 통신 효율이 전체 성능을 좌우하는 구조인 만큼, 관련 인프라 기업들의 기술 성장과 생산 속도도 상대적으로 빠르게 나타날 가능성이 있다.

대규모 클러스터 운영에 따른 전력과 열 문제도 중요한 변수다. 고밀도 연산 환경에서는 기존 공랭 방식의 한계가 뚜렷해지며, 액체냉각과 전력 인프라에 대한 수요가 동시에 확대되는 흐름이다. 이 과정에서 서버 ODM 역시 단순 조립 역할을 넘어, 복잡한 시스템을 통합 설계하는 방향으로 역할이 확대되고 있다.

DeepSeek V4의 가격 경쟁력은 인프라 아키텍처 혁신과 맞물려 형성된 결과다. 단일 칩 스펙에 의존하던 기존 접근에서 벗어나, 시스템 전반의 효율 최적화를 통해 한계 비용을 낮춘 구조적 성과로 해석된다. 이 변화는 중국 AI 산업의 투자 흐름이 모델 개발이나 칩 수급 등 개별 요소를 넘어 인프라 밸류체인 전반으로 확산될 가능성을 시사한다. 투자 관점에서는 미국과의 개별 기술 격차에 집중하기보다, 중국식 초노드 클러스터 확산과 인프라 고도화에 따른 시스템 수요 증가, 관련 생태계 성장에 주목할 필요가 있다.

표 1. AI 인프라 밸류체인별 변화 및 수혜 포인트

산업 영역	역할	핵심 변화 및 수혜 포인트	관련 기업
AI 반도체 (GPU/NPU 등)	연산 처리	AI 연산 수요 급증, 중국 자체개발 칩 중심으로 공급망 재편(Ascend 등)	Huawei, SMIC, Hygon, Cambricon, Moore Threads 등
PCB / 서버 기판	AI 서버 회로 기반	고다층·고집적(HDI·ABF) 구조 전환, 사양 고도화에 따른 단가 상승	선남서키트, 호사전자 등
광모듈 / 광인터커넥트	데이터 전송	데이터 트래픽 증가에 따라 800G·1.6T 등 고속 전송 수요 확대	중지쉬창, 신이성테크 등
스위치 칩 / 네트워크	클러스터 연결	GPU 간 인터커넥트 병목 부각, Scale-up 네트워크 중요성 확대	Huawei, Centec 등
액체냉각	열 관리	전력 밀도 상승에 따라 공냉 중심에서 액체냉각으로 전환 가속	잉웨이커
전력 인프라	전력 공급	고전력 수요 증가, HVDC 기반 전력 구조 및 데이터센터 전력 시스템 고도화	
서버 ODM	시스템 제조	단순 조립에서 벗어나, 통합 AI 서버 및 솔루션 공급자로 역할 확대	낭조정보, 폭스콘 등

자료: 미래에셋증권 리서치센터

그림 3. 중국 AI 산업 유니버스

구분	티커	종목명	시가총액 (십억달러)	기준일 증가 (위안/HKD)	수익률 (%)				Valuation		
					1W	1M	3M	YTD	P/E (TTM)	P/E (2026E)	P/B (MRQ)
빅테크	9988.HK	알리바바그룹홀딩스	309.77	126.50	-7.7	3.2	-25.5	-11.4	23.6	22.4	2.1
	9618.HK	JD	41.46	115.30	-5.8	5.1	5.3	7.1	15.0	10.7	1.3
	0700.HK	텐센트	551.67	473.80	-9.3	-4.0	-21.9	-20.9	17.4	15.4	3.4
	3690.HK	메이투안	63.26	80.30	-5.7	-6.5	-16.8	-22.3	-19.2	-42.1	3.0
	9888.HK	BAIDU	42.82	123.30	0.4	13.7	-20.6	-6.2	58.8	18.4	1.1
	1024.HK	KUAISHOU	23.45	42.28	-10.0	-8.2	-46.3	-33.9	8.9	10.4	2.1
반도체	0981.HK	SMIC	83.91	66.05	10.5	25.8	-13.8	-7.6	99.3	58.9	3.2
	1347.HK	화홍반도체	27.43	113.30	20.0	36.8	-0.8	52.5	461.0	134.6	3.8
	002371.SZ	베이팡화창	54.66	517.21	9.8	14.2	3.9	12.7	67.9	44.5	9.9
	688012.SH	AMEC	33.11	362.27	15.5	18.5	1.5	32.8	83.2	70.5	9.3
	600584.SH	JCET	11.77	45.10	1.4	14.1	-6.4	22.6	51.6	39.1	2.8
	002156.SZ	통푸마이크로	11.12	50.25	3.6	18.4	-5.6	33.3	62.6	48.3	4.9
	603501.SH	웨이얼반도체	18.94	103.89	10.8	2.8	-16.8	-17.5	32.4	26.7	4.7
	603986.SH	GigaDevice	31.83	307.50	5.8	18.9	0.1	43.5	130.8	64.8	11.3
	688041.SH	Hygon	97.94	289.00	10.4	30.8	6.8	28.8	246.4	149.3	28.6
	688256.SH	Cambricon	84.50	1,374.50	-0.3	34.2	5.7	1.4	281.5	111.5	49.0
	688795.SH	Moore Threads	48.55	708.48	9.6	28.2	17.0	20.5	-387.7	-411.6	28.9
	688002.SH	Meta X	42.23	724.01	2.3	21.0	26.5	24.8	-366.9	7653.4	22.0
6082.HK	Biren Tech	14.17	45.54	-7.1	59.3	31.6	32.2	-6.1	-94.2	-4.2	
LLM	2513.HK	Zhipu AI	45.51	800.00	-17.9	19.8	242.8	508.4	-167.9	-66.7	-39.8
	0100.HK	MiniMax	28.95	723.50	-20.6	-26.9	48.2	109.7	-15.6	-48.7	-11.0
H/W	601138.SH	FOXCONN	197.32	68.20	10.9	37.7	11.9	10.5	38.4	22.2	8.1
	603019.SH	중과서광	19.39	90.90	-1.2	11.6	-1.9	6.2	60.0	45.3	5.9
	000977.SZ	남조정보	15.16	70.83	-3.1	23.4	10.9	6.4	43.1	29.6	4.8
	000725.SZ	BOE	22.34	4.15	-1.0	5.1	-9.0	-1.4	26.2	17.0	1.1
	002475.SZ	압신정밀	74.23	69.88	6.3	38.1	30.5	23.6	30.7	23.4	6.0
	0992.HK	레노버	18.72	11.83	5.5	25.9	33.2	27.8	12.7	11.2	2.7
	2382.HK	순우광학테크	8.72	62.45	-5.7	16.2	-1.1	-4.7	13.3	14.4	2.1
0285.HK	비야디전자	7.54	26.24	-6.4	-14.2	-23.2	-22.0	15.2	11.0	1.6	
S/W	002230.SZ	산비정보	17.22	49.17	0.5	5.2	-15.4	-2.2	141.1	90.1	6.6
	688111.SH	Kingsoft Office	16.73	247.58	-0.8	2.9	-29.9	-19.4	31.6	46.8	7.6
	600588.SH	용우네트웍	5.84	11.72	-6.4	-0.6	-24.9	-11.6	-29.1	255.9	5.8
	0020.HK	SENSETIME	10.45	1.94	-5.4	4.3	-21.1	-11.8	-41.9	-51.0	2.8
	1357.HK	MEITU	2.42	4.13	-9.4	-12.7	-48.7	-41.0	29.3	13.7	3.0
	3888.HK	Kingsoft	4.08	23.14	-7.0	-2.5	-24.9	-18.6	14.4	18.1	1.1
0268.HK	금접소프트웨어	3.73	8.23	-11.6	-6.8	-40.5	-38.1	284.0	59.5	3.2	
통신 (서비스)	600941.SH	차이나모바일	236.80	96.03	2.9	2.8	1.9	-5.0	15.3	15.4	1.4
	601728.SH	차이나텔레콤	76.84	5.98	2.4	4.9	3.8	-5.1	17.3	18.3	1.2
	600050.SH	차이나유니콤	20.65	4.53	-1.3	0.9	-10.7	-11.4	16.4	16.8	0.8
통신 (CPO/PCB)	000063.SZ	ZTE	23.51	36.01	0.5	10.2	-10.4	-4.8	38.5	22.5	2.2
	300308.SZ	중지쉬창	133.95	825.00	-2.9	38.0	34.0	35.2	61.5	34.3	25.8
	002916.SZ	쎄난서킷	31.28	314.93	9.5	35.1	24.0	35.6	59.0	41.0	11.9
	002281.SZ	광신과기	16.11	137.00	14.1	62.1	90.4	95.9	106.7	65.1	10.7
냉각	002837.SZ	잉웨이커	13.23	92.84	-23.3	-0.3	-5.2	-13.1	188.0	76.7	26.2
휴먼노이드	9880.HK	유비테크	6.62	103.10	-5.7	13.3	-26.9	-18.4	-66.7	-144.5	6.5
	2498.HK	ROBOSENSE	1.99	32.22	-11.7	-5.3	-8.6	-12.0	-96.6	131.8	3.7
	601689.SH	탁보그룹	14.36	56.67	-6.4	-1.9	-24.8	-26.6	35.4	28.5	4.1
	002050.SZ	삼화	25.92	44.16	-3.9	1.9	-15.5	-20.0	45.7	38.8	5.9
	300124.SZ	후이촨테크	24.22	61.36	-7.8	-10.5	-21.8	-18.5	35.0	26.0	4.6
601100.SH	항립유항	20.43	104.52	1.2	9.1	-7.4	-4.9	50.6	40.2	7.8	
자율주행	9660.HK	Horizon	13.50	7.22	-6.0	5.7	-18.7	-16.6	-9.1	-32.0	7.6
	2533.HK	Black Sesame	1.53	17.65	-1.0	9.8	-15.1	-8.5	-7.6	-11.3	-1.1

* 추천종목 아님

자료: Wind, 미래에셋증권 리서치센터 (2026.4.28 기준)

Compliance Notice

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.